

Aufgabe

Herstellung von Dünnschichten durch Sputtern mit bis zu zwei Targets gleichzeitig

Technische Daten

Allgemein:

- Einkammersystem
- Targets:
 - 1 x 2" DC Magnetron (seitlich)
 - 1 x 5" RF Magnetron (top down)
 - 1 x 5" DC Magnetron (top down)
- Substrateheizung ($T_{max} = 400^{\circ} C$) während des Prozesses möglich
- Typische Materialsysteme: CrNi, SiO_2 , Al_2O_3 , Pt- SiO_2 , Ni- SiO_2

Funktionsweise

